

第1号議案

平成25年度事業報告書

自：平成25年4月1日 至：平成26年3月31日

1. 全般

- (1) 大会事業については、計画通り、国際会議ICEP 2013、第23回マイクロエレクトロニクスシンポジウム（MES2013）、2013ワークショップ、第28回春季講演大会を開催し最新の実装技術に関する情報交換の場を提供した。ICEP2013をはじめとして、昨年を上回る参加者を集め、大会事業の収支改善にも貢献した。
- (2) 展示会事業については、JPCA Showと同時開催するマイクロエレクトロニクスショーの展示企画として、最先端実装技術シンポジウム、アカデミックプラザ、eX-techを企画・運営し、展示会参加者への学会活動の情報発信、産学共同の情報交流の場の提供を行うとともに、展示会集客にも大いに貢献した。
- (3) 技術調査事業については、昨年度から継続した13技術委員会、23研究会の体制で、エレクトロニクス実装の具体的な技術テーマについて、調査活動を行い委員相互の情報交換を行うとともに、それらの成果や関連する最新技術動向について、公開研究会や学会誌を通じて広く情報発信した。公開研究会は合計34回開催した。また、現在の活動領域を整理し、今後の展開検討の基礎資料となる「実装技術分野マップ」を作成し公開した。
- (4) 教育事業については、教育講座および教育セミナーを実施し、実装技術の普及と技術者の育成に貢献した。一昨年度好評だった表計算ソフトを使う演習を中心にした「伝熱解析セミナー」を再開した。
- (5) 会誌発行事業については、学会誌 7回および英文論文誌 1回を発行し、実装技術の普及に貢献した。今年度から、英文論文誌は電子発行に切替え、学会ホームページ等からの一般閲覧が可能になったため、海外向け情報発信が強化された。
- (6) 国際事業については、国際会議ICEP2014開催に係るIEEE CPMT Society Japan Chapter、IMAPSとの連携関係を確認するため、双方とそれぞれMOUを締結した。
- (7) 支部事業については、関西支部では、設立10周年を記念して、「関西支部10周年記念講演大会」（第10回技術講演会、2014.1.20 京都リサーチパーク）を開催した。また、関西ワークショップ、若手研究会セミナーおよび「ぶらっと関西」（工場見学付講演会）を開催し、地域活動を積極的に展開した。
- (8) 表彰事業については、例年どおり、実装技術分野の学術・技術的な進歩発展への貢献や学会の発展・運営に貢献した方々を表彰した。今期から、技術功労賞については、賛助会員企業社員を対象とする技術貢献を「マイスター賞」と、学会事業活動の貢献者を対象とする「功労賞」に分離し、改称した。

2. 学会運営体制

(1) 財務体質の安定化

大会事業、公開研究会等イベントへの参加者増強のため、企画組織の強化や学会ホームページや一斉メールによる情報発信を実施した。学会運営費用適正化のため、事務局体制の見直しを行い、事務局作業の効率化にも着手した。

今期は、大会事業、教育事業の参加者増加や会誌発行事業の広告収入増加により、損益が大幅改善したが、一過性の部分もあり、会員漸減傾向も続いており、一段の対策が必要となっている。

(2) 会員数の増強

若手リーダを育成すると共に、彼らを中心とする若い力を発揮する場を提供するため、新

たにミッションフェロー制度を設置し、17名を任命した。新規領域拡大の活動など、学会活動活性化、魅力アップにより新たな会員獲得を目指している。

現会員に対し、学会の舵取りをする理事会をより理解して貰うため、前年度に続き、新任役員からのメッセージを学会誌に掲載した。

平成23年度から導入した「シニア会員制度」、「賛助会員向けクーポン券」の利用状況及び効果については引続き調査を継続する。

3. 大会事業活動報告（定款第4条第1号関係）

(1) 「国際会議 ICEP 2013」（組織委員長 山道新太郎氏 ルネサスエレクトロニクス）

2013. 4. 10～12、大阪国際会議場にて、IEEE CPMT Society Japan Chapter、IMAPS と共催で「国際会議 ICEP 2013」を開催し、国際交流を推進できた。総計 174 件(Keynote 3 件含む)の口頭発表、16 件のポスター発表があった。発表者も含めた参加者は 388 名。

(2) 「第23回秋季大会マイクロエレクトロニクスシンポジウム」（組織委員長 上西啓介教授 大阪大学）

2013. 9. 11～12、大阪大学 吹田キャンパスにて開催した。講演 116 件（招待講演、依頼講演、ものづくりセッション含む）の発表があった。大学研究室紹介コーナーでは、ポスター 5 件の掲示を行った。また、「鴻海精密工業の昨日・今日・明日」（中川威雄氏 ファインテック）と「電子デバイス実装における研究開発の展開と課題 -微細接合を中心に-」（藤本公三教授 大阪大学）の招待講演を行った。参加者は 424 名。

(3) 「2013 ワークショップ」（実行委員長 笹岡達雄氏 パナソニック）

「サステナブル社会実現に向けた実装技術の貢献～驚きと感動を与える”何か”を実装で実現しよう～」をテーマに、ラフォーレ修善寺にて、2013. 10. 17～18 で開催した。特別講演「未来予測 2013 - 2025」（田中栄氏 アクアビット）及び、ナイトセッション「人と機械の新たな関係を創る」（藤本弘道氏 アクティブリンク）を実施した。発表 47 件、参加者は 74 名。

(4) 「第28回春季講演大会」（講演大会委員長 澁谷昇教授 拓殖大学）

「多様な世界を切り拓く実装技術」と題して、拓殖大学 文京キャンパスにて、2014. 3. 5～7 で開催した。特別講演は「ニューロニクス -神経回路と電子回路のインターフェイス-」（川名明夫副学長 拓殖大学）、「ミニマルファブ構想 -半導体製造技術の革新を目指して-」（井上道弘研究参与 産業技術総合研究所）の 2 件。一般講演 117 件、依頼講演 18 件、ポスターセッション 15 件、ものづくりセッション 31 件、チュートリアル 6 件であった。参加者は 621 名。

4. 展示会事業活動報告（定款第4条第1号関係）

(1) 「最先端実装技術シンポジウム、アカデミックプラザ及び、eX-tech2013」

JPCA Show (2013. 6. 5～7、東京ビッグサイト) と同時開催するマイクロエレクトロニクスショーの展示企画として、最先端実装技術シンポジウム、アカデミックプラザ及び、eX-tech2013 を実施した。最先端実装技術シンポジウムは 12 セッション 35 講演を実施し、聴講者は延べ 592 名だった。アカデミックプラザは 41 件の発表があり聴講者は延べ 872 名。また 2 件のアカデミックプラザ賞を授与した。eX-tech2013 には 15 社の出展があった。

(2) 「セミコン・ジャパン 2013 への展示」

2013. 12. 4～6 幕張メッセにて開催したセミコン・ジャパン 2013 に、当学会活動を紹介するパネル 8 枚、H24 年度の技術賞、論文賞のパネル各 2 枚を展示した。ブース来場者は延べ 450 名。

5. 技術調査事業活動報告（定款第4条第2号関係）

(1) 技術委員会の活動

前年に続き、13の技術委員会を組織し、実装技術分野の技術動向を調査し、「エレクトロニクス実装技術の現状と展望」と題した特集記事を学会誌1月号に掲載した。また、現在の活動を整理し、今後の展開検討の基礎資料となる「実装技術分野マップ」を作成し公開した。大会事業や展示会事業に委員を派遣し、各イベントの企画運営を支援した。

(2) 研究会の活動

前年に引き続き、各技術委員会の傘下に合計23の研究会を組織し、具体的な個々の実装技術テーマについて、調査活動を行い委員相互の情報交換を行った。エレクトロニクス実装技術領域の変化に対応するため、新しい分野の研究会の立上げの下地作りを行った。

研究会組織見直しにより、「錫ウイスカ研究会」については、計画された活動を完了し、2014年4月開催の公開研究会での最終報告をもって解散することになった。

(3) 技術調査事業活動成果の普及

技術委員会および研究会の活動で得られた成果については、公開研究会や学会誌などで広く公開した。開催した公開研究会等は以下のとおり。

| 担当研究会等 | 開催日 | 会場 | 参加人数 | 概要 |
|-------------------------|-------------|------------|------|--|
| 機能性ハイブリッド研究会 (1) | 10/25 | 回路会館 | 15 | 「環境エレクトロニクス材料と解析技術」をテーマに講演6件 |
| 〃 (2) | 2/24 | 回路会館 | 46 | 「医療の進化を支える実装技術」をテーマに講演4件 |
| システム実装-CAD/CAE (1) | 6/4 | 回路会館 | 44 | 「目からうろこのEMC設計」をテーマに講演4件 |
| 〃 (2) | 11/26 | 回路会館 | 26 | 「システム設計におけるグラウンドとEMC ～カーエレクトロニクスとEMCの現状～」をテーマに講演4件 |
| 電磁特性技術委員会 (1) | 7/11-12 | 機械振興会館 | 50 | 電子情報通信学会 EMCJ 研究会との協賛研究会 若手研究会 (7/11) と一般研究会 (7/12) |
| 〃 (2) (サマーセミナー) | 8/28 | 国士舘大学 | 149 | 「学ぶ人も教える人も基礎からわかる EMC ～ここに気付くと EMC は面白い～」をテーマに講演5件、パネルディスカッション1件 |
| 低ノイズ研究会 (1)～(8) | 6月より 11月 | 回路会館 | 46 | EMC設計技術実践講座(8回) |
| 超高速・高周波エレクトロニクス実装研究会(1) | 5/24 | 杉並区 勤労福祉会館 | 40 | 「プリント基板の給電線路形状によるデカップリングコンデンサの効果」など講演5件、製品技術紹介1件 |
| 〃 (2) | 7/26 | 回路会館 | 61 | 「高速伝送技術を用いた伝送路設計」など講演7件、製品技術紹介2件 |
| 〃 (3) | 11/15 | 回路会館 | 31 | 「液晶ポリマーフィルムへの回路形成方法について」など講演6件 |
| 〃 (4) | 2/21 | 岡山大学 | 35 | 「中小型フラットパネルディスプレイ用フレキシブルプリント基板の高速伝送技術」など講演5件、製品技術紹介1件 |
| マイクロ・ナノアプリケーション研究会 (1) | 7/17 | 回路会館 | 63 | 「期待の高まるプリントエレクトロニクスの最新動向」をテーマに講演5件 |

| | | | | |
|-----------------------|-------|------------|-----|--|
| 〃 (2) | 9/20 | 回路会館 | 87 | 「モバイル機器用半導体パッケージの最新実装技術をテーマに講演 5 件 |
| 〃 (3) | 12/17 | 回路会館 | 88 | 「これからのモバイル機器を目指したパッケージ、インターポーザ技術」をテーマに講演 5 件 |
| ECM 研究会 (1) | 11/1 | 回路会館 | 80 | 「従来の高加速試験の考え方を変える新たな検証!! -HAST・Air-HAST を使用した高加速試験より評価の限界を探る-」をテーマに講演 6 件 |
| 先進実装・電子部品技術研究会 (1) | 5/21 | 回路会館 | 70 | 「我が国実装技術者を元気づける講演&接合技術最前線」をテーマに公開講演会を開催、講演 5 件 |
| 〃 (2) | 8/29 | 回路会館 | 73 | 「JEITA 発行・電子部品技術ロードマップ 2013 報告会 -変化する将来の生活環境と、世界をリードする電子部品の動向-」をテーマに講演 9 件 |
| 〃 (3) | 11/20 | 溶接会館 | 85 | 「次世代鉛フリーはんだ・接合材料・接合法」をテーマとする溶接協会公開研究会に協賛 |
| 〃 (4) | 12/10 | 横浜国立大学 | 61 | 「パワーエレクトロニクス実装技術」をテーマとする YJC 公開研究会に協賛 |
| ボードテスト技術研究会 | 1/24 | 回路会館 | 32 | 「競争力のあるものづくり ~適正品質を目指した基板検査~」をテーマに講演 5 件 |
| OPT 研究会 (1) | 7/8 | 回路会館 | 11 | 「光配線技術の最新動向」をテーマに講演 6 件 |
| 〃 (2) | 10/15 | 回路会館 | 12 | 「光インターコネクタ技術 ~材料/デバイスからモジュールまで~」をテーマに講演 3 件、海外動向調査 1 件 |
| 〃 (3) | 1/17 | 回路会館 | 30 | 「光インターコネクションの普及とさらなる進展」をテーマに講演 9 件 |
| 環境と実装研究会 (1) | 8/21 | 回路会館 | 60 | 「炭素材料とその応用技術」をテーマに講演 5 件 |
| 〃 (2) | 10/16 | 回路会館 | 14 | 「世界の環境規制最新動向と行き過ぎた環境対応への警鐘」をテーマに講演 1 件 |
| システムインテグレーション実装技術研究会 | 10/29 | 回路会館 | 109 | 「3D, 2.5D, 2.1D 実装の未来は? 専門家による徹底討論」のテーマで講演 6 件 |
| e-テキスタイル研究会 (1) | 12/20 | 大阪科学技術センター | 23 | 「繊維状基材への微細化技術」など講演 2 件 |
| EPADs 技術調査研究会 (1) | 7/9 | 回路会館 | 101 | 「部品内蔵基板とこれを支える基板技術」をテーマに講演 5 件 |
| 〃 (2) | 9/27 | 回路会館 | 64 | 「部品内蔵基板ビジネスに欠かせない高歩留り・リワーク技術」をテーマに |
| 〃 (3) | 11/28 | 回路会館 | 51 | 「部品内蔵基板とこれを支える設計技術動向」をテーマに講演 6 件 |
| 〃 (4) 次世代配線板研究会と合同 | 2/14 | 回路会館 | 89 | 「部品内蔵基板・次世代配線板の最新技術動向」をテーマに講演 6 件 |
| サーマルマネジメント研究会 (1) | 11/26 | 中央大学 | 26 | 「コンピュータシステムの冷却設計と熱流体シミュレーション」など講演 3 件 |
| プリンタブルデバイス研究会 (1) | 10/23 | 東京大学 | 76 | 「プリンタブルエレクトロニクスの新しい展開と機能化技術」をテーマに講演 5 件 |
| 〃 (2) | 1/23 | 回路会館 | 44 | 「プリンタブルエレクトロニクスの新しい展開と |

| | | | | |
|-----------------|------|------|----|---|
| 先進実装・電子部品研究会と合同 | | | | 機能化技術」をテーマに講演 3 件 |
| 官能検査自動化研究会 (1) | 7/24 | 回路会館 | 34 | 「画像検査、外観検査の最新技術の紹介と次代へ向けた提案」をテーマに講演 4 件 |
| 〃 (2) | 1/29 | 回路会館 | 33 | 「画像処理、粘着・接着評価、外観検査の実際と最新技術動向」をテーマに講演 4 件、製品技術紹介 3 件 |

6. 教育事業活動報告 (定款第 4 条第 3 号関係)

(1) 教育講座の実施

①PWB 製造・初級コース(2013. 6. 26～27 回路会館)

新入社員、営業担当者向けに、広い技術分野にまたがるプリント配線板について、基礎知識の修得を目標とした初級コースの教育講座を実施した。受講者は 45 名。

②第 13 回実装技術総合講座 (2013. 10. 23～24 回路会館)

企業で実装技術に関わる中堅技術者や、これから実装技術に関わる異分野の技術者を対象として、実装技術総合講座を実施した。受講者は 31 名。

(2) 教育セミナーの実施

①第 58 回定例セミナー (2013. 10. 7 回路会館)

基調講演「パワーエレクトロニクスにおける実装の役割」(山口浩氏 産業技術総合研究所) ほか一般講演 4 件を実施した。受講者は 58 名。

②第 59 回定例セミナー (2014. 2. 3 回路会館)

基調講演「ワイヤレス通信機器の進化を支える(実装)材料の最新動向」(本城和彦教授 電気通信大学) ほか一般講演 4 件を実施した。受講者は 17 名。

③伝熱解析セミナー・初級編 (2013. 11. 5 回路会館) / 中級編 (2014. 2. 18 回路会館)

新規教育講座として、表計算ソフトを使う演習を中心にした伝熱解析セミナーの初級編と中級編とを実施した。伝熱解析の基礎と演習の初級編と中級編。広島国際大学・大串哲郎講師により指導。実際にエクセルファイルを使用し、受講者自ら課題に取り組む。受講者は初級編 10 名、中級編 23 名。

7. 会誌発行事業活動報告 (定款第 4 条第 4 号関係)

(1) エレクトロニクス実装学会誌の発行

例年通り、機関誌「エレクトロニクス実装学会誌」を 7 回発行した。研究開発活動の成果として研究論文、速報論文、技術報告等を掲載し、実装技術に関する最新情報を会員に提供した。編集委員会企画特集号(9月号)では「実装技術の歴史」をテーマに実装技術全般からプリント配線板、電磁界シミュレーション、フリップチップ実装技術、電池に実装技術まで多彩な分野の歴史について 5 件の特集記事を掲載した。また、理事会や各事業委員会の活動状況についても広報した。

(2) 英文論文誌の発行

論文数 17 件を掲載した英文論文誌 Transactions of The Japan Institute of Electronics Packaging Vol.6 を 2013 年 12 月に発行した。学会英文ホームページ及び J-STAGE (科学技術振興機構の総合電子ジャーナルプラットフォーム) から一般閲覧できるようにした。J-STAGE からのダウンロード数は月間 1,000 件前後。

(3) 学会誌の電子投稿システム

投稿・編集業務に採用したオンライン投稿審査システム(Editorial Manager®)の全面利用を

開始した。投稿論文 34 件。

(4) 韓国語翻訳転載

学会誌の解説記事および論文のうち 39 件が、雑誌「表面実装技術」（韓国 尖端社 発行）に翻訳転載され、国際普及が進められた。

8. 国際事業活動報告（定款第 4 条第 5 号関係）

(1) 国際会議 ICEP に係る連携関係の明確化

ICEP2014 について、エレクトロニクス実装学会主催、IEEE CPMT Society Japan Chapter 共催とし、IEEE に投稿論文の著作権の一部使用を許諾する MOU（Memorandum of Understanding：了解覚書）を IEEE と締結した。（開催ごとに都度締結予定）IMAPS については、これとは別に IMAPS との連携に必要な内容に改訂して MOU を締結した。

9. 支部事業活動報告（定款第 4 条第 6 号関係）

(1) 関西支部

① 関西ワークショップ（2013. 7. 18-19 ラフォーレ琵琶湖）

ナイトセッション（1 日目）では「日本実装業界の将来像」のテーマで、講師 5 名のショート講演の後、各講師グループに分かれて討議。2 日目は 2 講演「3D 集積化のための低温接合」（東京大学 須賀唯知教授）、「近未来の実装技術はニッポンが切り開く ～ I T ・医療・環境の新分野に多角展開しよう」（産業タイムズ社 泉谷渉代表取締役）の後、パワーエレクトロニクス、3D インテグレーション、部品内蔵基板など 10 テーマ分野で 30 件のポスタ発表が行われた。参加者は 100 名。

② 第 18 回若手研究会 세미나（2013. 11. 19 大阪府立大学 I-site なんば）

「部品内蔵基板とその実装技術 -基礎から三次元化、将来展望まで-」をテーマとして、福岡県産業・科学技術振興財団 三次元半導体研究センター 友景肇センター長（福岡大学教授）の講義を行った。部品内蔵基板製造技術の基礎から現在の技術動向、今後の展開ならびに超高密度な実装技術を実現するための技術課題について講義が行われた。受講者は 34 名。

③ 「ぷらっと関西」（2013. 11. 29 立命館大学びわこ・くさつキャンパス）

立命館大学「SR(シンクトロン放射光)センター」、「先端マイクロ・ナノシステム技術研究センター」を見学後、「ポリマーMEMS 製作技術の開発と応用」（立命館大学 杉山進教授）の講演があった。参加者は 28 名。

④ 関西支部 10 周年記念講演大会（第 10 回技術講演会、2014. 1. 20 京都リサーチパーク）

「明日のエレクトロニクスを牽引する未来技術」をテーマに、最先端実装パッケージに関する材料、プロセス、基板構造等の各種要素技術から、メディカル関連の iPS 細胞技術までの未来技術についての国際記念技術交流講演会を開催した。「TSV Process and Business Opportunities with cost estimation」（Kangnam University Gun-Sung Kim 教授）など、6 講演を行った。参加者は 89 名。

⑤ 第 19 回若手研究会 세미나（2014. 2. 19 大阪府立大学 I-site なんば）

「現場で役立つ信頼性評価技術」というテーマで、「商品とお客様との対話から考える信頼性評価」（伊藤貞則顧問 日本信頼性学会関西支部）など、3 講演を行った。受講者は 30 名。

(2) 九州支部

九州大学バイオメカニクス研究センターと合同研究会を行った。外国人 8 名を含む 70 名の参加があり、産業界からの参加者も増加して年々活発化している。

10. 表彰事業活動報告（定款第 4 条第 6 号関係）

学会活動の活性化と研究開発者のモチベーション向上のために以下の表彰を行った。

今年から、熟練した技量又は卓越した技術によりエレクトロニクス実装技術の発展に貢献した方を表彰するマイスター賞を新たに設置し、2名の方が受賞した。

(1) 学会賞 (1 件)

「鉛フリーはんだ実装およびプリントドエレクトロニクスの新材料実装技術の実用化推進と標準化活動に対する貢献」 菅沼克明 (大阪大学)

(2) 功績賞 (1 件)

「永年にわたる光回路実装技術委員会活動における学会の発展及び運営に対する貢献」 三上修 (東海大学)

(3) 技術賞 (2 件)

① 「ウエハレベルシステムインテグレーション (擬似 SoC) 技術の研究開発と実用化」

山田浩、小野塚豊、鈴木琢治、南重信 (東芝)、大島信洋、佐藤靖宏 (東芝ホクト電子)、平井浩之 (東芝ディーエムエス)

② 「SAW フィルタと LTCC 基板を用いた広帯域フィルタで構成した高周波分波回路の開発と試作評価」

和田光司 (電気通信大学)、勝本達也 (日本無線)、大島心平 (小山工業高等専門学校)、村田龍司、海老原均 (太陽誘電)

(4) 論文賞 (2 件)

① 「導電性接着剤における電極間導電経路の 3 次元可視化」

荒尾修、新帯亮、杉浦昭夫 (デンソー)

② 「PWB における IVH の熱疲労寿命に及ぼす FR-4 の積層構造の不均質性の影響 (第 1 報, 冷熱サイクル試験と有限要素法解析を用いた寿命の変動要因の検討)」

竹中国浩 (安川電機)、于強 (横浜国立大学)

(5) 功労賞 (2 件)

① 梶谷林 (日立製作所): 「永年にわたる検査技術委員会活動における学会発展に対する貢献」

② 箕輪俊夫 (旭硝子): 「永年にわたる学会誌発行事業における学会発展に対する貢献」

(6) マイスター賞 (2 件)

① 川上幹夫 (東レエンジニアリング): 「アライメント技術開発とフリップチップボンダー装置の高精度化への貢献」

② 原悟 (東芝): 「鉛フリーはんだ接続の評価解析技術開発と品質向上への貢献」

(7) 春季講演大会表彰

第 27 回講演大会【講演大会優秀賞】 (5 件)

① 13A-06 「チップ部品の電極部への選択的無電解めっき膜形成」

小岩一郎、中田龍之介、福井健太、渡辺宣朗、橋本晃 (関東学院大学)

② 15C-05 「左手系導波管を用いたミリ波帯スロットアレーアンテナの基礎検討」

小松真奈、山本隆彦、越地耕二 (東京理科大学)

③ 15A-08 「らせん巻フィルムを用いた高機能・多機能なカテーテル・内視鏡の開発」

松永忠雄、石代宗之、芳賀洋一 (東北大学)

④ 14A-12 「100GByte/s の伝送能力を有する超ワイドバス SiP の開発」

内山士郎、坂井篤、小林治文、池田博明 (技術研究組合 超先端電子技術開発機構)

⑤ 15E-14 「レーザーによる樹脂表面改質技術を用いた MID」

齋藤裕一、渡辺充広 (日本表面処理研究所)、湯本哲男 (三共化成)、菅野信 (三共精密金型)

第 27 回講演大会【研究奨励賞】 (5 件)

①15A-14「結晶品質制御によるめっき銅薄膜配線の信頼性向上」

浅井修（東北大学）

②14B-06「透明な紙を用いたプリンテッドペーパーエレクトロニクス」

古賀大尚（大阪大学）

③13E-11「電磁誘導式 MEMS エアタービン発電機に用いる積層セラミック磁気回路についての検討」

金子真人（日本大学）

④3F-02「ベンゾオキサジン変性ビスマレイミドとシアン酸エステルから成る高耐熱性樹脂」

岡本真（横浜国立大学）

⑤15C-16「ディスペンサを用いたシングルモードポリマー光導波路の作製」

菅沼大輔（慶應義塾大学）

第 28 回講演大会【ポスターアワード】（2 件）

①5PD-03：「溶融鉛フリーはんだ中での炭素鋼材料の初期腐食挙動」

上杉広大（群馬工業高等専門学校）

②5PD-13：「アンダーフィル材料の時間依存ポアソン比の測定」

島田宏地（芝浦工業大学）

(8) 秋季大会 MES2013 表彰

【ベストペーパー賞】（5 件）

①1B1-5：「バインダケミストリに着目した導電性接着剤の微細組織制御」

井上雅博、多田泰徳（群馬大学）、牟田浩明、山中伸介（大阪大学）

②2A1-2：「ポリイミドフィルムへの密着性に優れた高精細銅配線プロセスの開発」

白髪潤、富士川亘、村川昭、斉藤公恵、義原直（DIC）

③2D3-3：「Cu 充填 Al 陽極酸化膜を応用した高密度配線基板の開発」

松田勇一、深澤亮、徳武安衛、堀内道夫、小林壯（新光電気工業）

④2D3-5：「低温バイアス下におけるアルミナ粒界中の Ag デンドライトの発見と説明」

中村俊浩、今田真嗣、浅井康富、大谷祐司（デンソー）

⑤2D4-4：「熱履歴を受ける樹脂の粘弾性特性変動を考慮した積層パッケージの反り解析」

池田徹（鹿児島大学）、河原真哉（京都大学）、宮崎則幸（京都大学、九州大学）、畑尾卓也（住友ベークライト）

【研究奨励賞】（5 件）

①1B1-3：「エポキシ/銀コンポジットの電氣的・熱的特性に及ぼす樹脂特性の影響」

入船晃（関西大学）

②1C2-3：「励振コイルとして円型コイルアレーと楕円形コイルを用いた場合のワイヤレス電力伝送の比較」

堀米滉平（国士舘大学）

③2A1-3：「パラジウム触媒を含んだポリシルセスキオキサン薄膜上への無電解銅めっきの形成」

手嶋彩由里（奥野製薬工業）

④2A3-2：「放熱用金属バルク材料と電子デバイス用ウエハの大気中低温接合技術の開発」

今一恵（東北大学）

⑤2B4-2：「微小流路型反応器を用いた異種ハロゲンイオン存在下におけるポリエチレングリコール吸着挙動の解析」

辻本悠一（大阪府立大学）

(9) ICEP2013 表彰

【ベストペーパー賞】(5件)

- ①WD2-2: "Transient Heat Transfer of The Microprocessor System Investigation regarding Natural Convection with Slate Style Chassis"
K. Nishi (AMD Japan), T. Hatakeyama, M. Ishizuka (Toyama Prefectural University / Japan)
- ②TA2-1: "Cooling Strategy and Structure of 3D Integrated Image Sensor for Auto-mobile Application"
F. Yamada, K. Matsumoto, H. Kobayashi, K. Sueoka, A. Horibe, S. Kohara, H. Mori, Y. Orii (Association of Super-Advanced Electronics Technology / Japan)他
- ③TD3-4: "Room-Temperature Direct Bonding of GaAs and SiC Wafers for Improved Heat Dissipation in High-Power Semiconductor Lasers"
E. Higurashi, K. Nakasuji, T. Suga (The University of Tokyo / Japan)
- ④FB1-4: "Via Formation Process to Form the Smooth Copper Wiring Using Adhesion Layer"
S. Sasaki, M. Tani (Fujitsu Laboratories / Japan)
- ⑤FE2-1: "Multiscale Modeling of Anisotropic Creep Response of Heterogeneous Single Crystal SnAgCu Solder"
S. Mukherjee, A. Dasgupta (University of Maryland / USA)
- 【ポスターアワード】(1件)
- ①Poster-12: "A Proposal of New Electrode Structure for Intra-Body Communication"
T. Fujisawa, F. Koshiji (Kokushikan University / Japan)他

11. その他の活動報告 (定款第4条第5号関係)

(1) 関連学協会の各種事業との協力活動

電子情報通信学会、応用物理学会、電気学会、溶接協会、表面技術協会など22学協会、41件の講演大会などの行事について協賛・後援した。一方、秋季大会MESおよび春季講演大会では23学協会から協賛を受けるなど、相互に交流を深めた。Mate2014、MES2013については特に関連深いスマートプロセス学会エレクトロニクス生産科学部会との共催で実施した。また、支部レベルでは、関西にある他の学協会支部と相互に協賛を行い活動の活性化に寄与した。

12. 平成26年3月31日現在の会員数

| | | |
|--------|--------|--------------|
| 正会員 | 2,375名 | (前年同期比 53名減) |
| 学生会員 | 194名 | (前年同期比 1名増) |
| 賛助会員 | 155社 | (前年同期比 6社減) |
| 賛助会員口数 | 316口 | (前年同期比 6口減) |